

本資料由 (上市公司) 統懋 公司提供

序號	1	發言日期	104/05/13	發言時間	19:16:58
發言人	賴政麟	發言人職稱	海外事業部副總	發言人電話	06-5991621
主旨	公告新增資金貸與達本公司最近期財務報表淨值百分之十以上者				
符合條款	第 23 款	事實發生日	104/05/13		
說明	<p>1. 事實發生日:104/05/13</p> <p>2. 接受資金貸與之:</p> <p>(1)公司名稱:和懋半導體(四川)有限公司</p> <p>(2)與資金貸與他人公司之關係:</p> <p>100%持有子公司</p> <p>(3)資金貸與之限額(仟元):436025</p> <p>(4)原資金貸與之餘額(仟元):0</p> <p>(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):159059</p> <p>(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否</p> <p>(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):159059</p> <p>(8)本次新增資金貸與之原因:</p> <p>本公司對子公司部份應收帳款轉列資金貸與</p> <p>3. 接受資金貸與公司所提供擔保品之:</p> <p>(1)內容:</p> <p>無</p> <p>(2)價值(仟元):0</p> <p>4. 接受資金貸與公司最近期財務報表之:</p> <p>(1)資本(仟元):308865</p> <p>(2)累積盈虧金額(仟元):-86479</p> <p>5. 計息方式:</p> <p>無</p> <p>6. 還款之:</p> <p>(1)條件:</p> <p>一年到期本金一次償還</p> <p>(2)日期:</p>				

同上

7. 迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

159059

8. 迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

14.59

9. 公司貸與他人資金之來源:

母公司

10. 其他應敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。